

「かしめ取扱説明書」

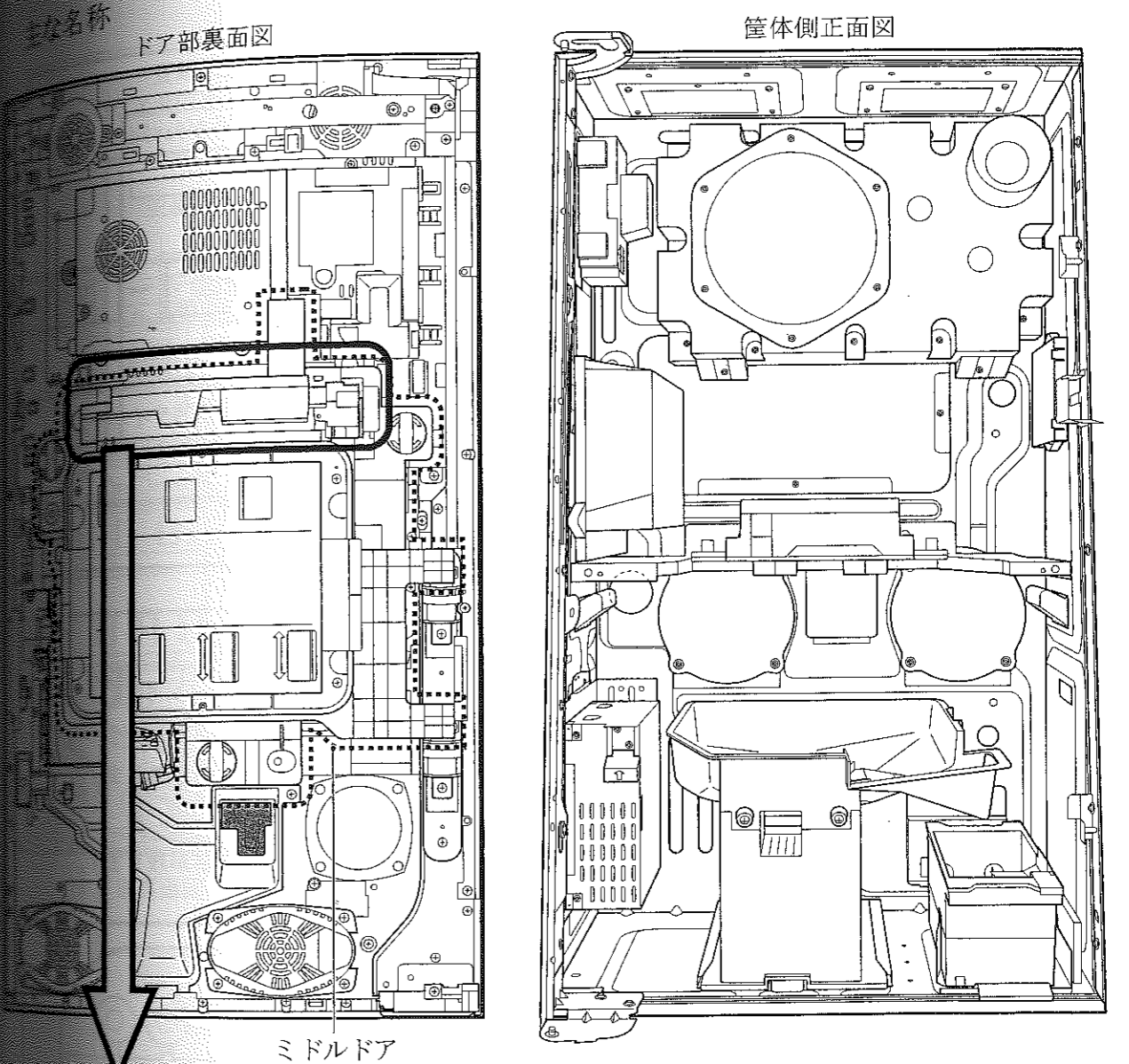
○ホール責任者へのお願い（かしめの点検方法と注意事項）

1. かしめの全体図と部品構成
2. 立入検査工程の流れ図
3. 開封作業手順 ① ~ ④
4. 封印作業手順 ⑤ ~ ⑧
5. 記録作業手順 ⑨
6. その他（主基板回収時作業手順）

○ホール責任者へのお願い（かしめの点検方法と注意事項）

1. 遊技機納入後はホール側において、セキュリティ維持のため「かしめ」のかしめ点検確認をお願いします。
2. 点検方法としては、「かしめ」の封印状態を確認し、主基板樹脂ケース上に貼付した「かしめ使用記録」の記載内容と、実際の封印が必ず一致していることを確認してください。
3. この「かしめ」の開封又は封印に関しては、遊技機製造業者（遊技機製造業者が認めた者を含む）が行います。また、立入検査にて各都道府県公安委員会（警察官）が、「かしめ」の開封や再封印を行うことがあります。
4. 「主基板樹脂ケースの封印」並びに「筐体固定封印」の各封印箇所が切断されたまま使用されていたり、「かしめ」の使用記録と実際の「かしめ」との整合性がない場合には、製造メーカーは一切の責任を負わないものとします。

1. かしめの全体図と部品構成



主基板封印大図(上方より)

ケース封印 (A) 本体封印 (B) (C)

封印シールカバー

記録紙

主基板及び主基板樹脂ケース

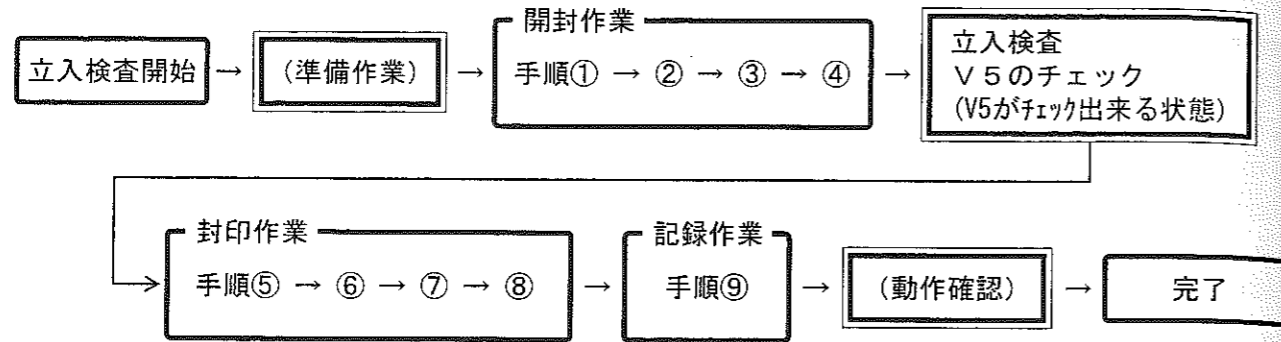
封印キャップ

コネクタカバー

メイン24Pハーネスコネクタ

かしめ使用記録			
	用途	年月日	担当者
(A)			
(B)	本体固定用		
(C)	立入検査		
(F)	基板回収用		

2. 立入検査工程の流れ図

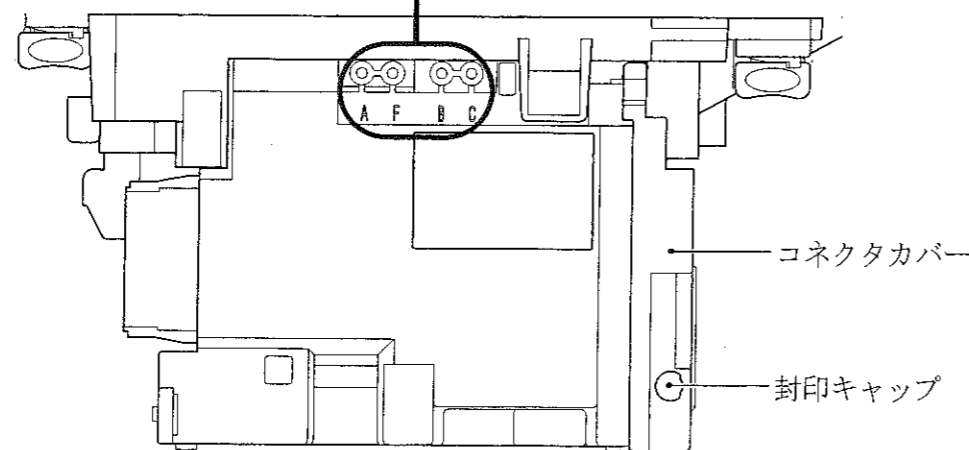
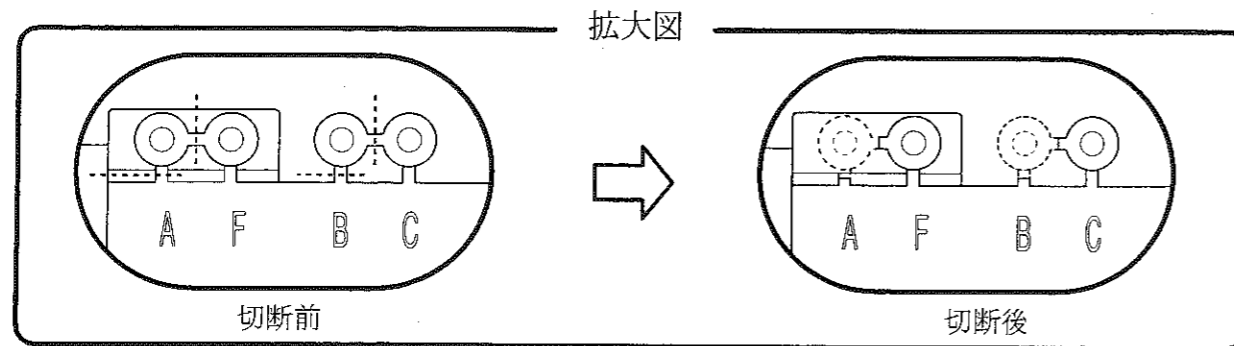


(準備作業) ・あらかじめ、プラス(+)ドライバー、先の細いマイナス(-)ドライバー、油性サインペンまたはボールペン、ニッパー等を用意してください。
 ・必ず遊技機の電源を切ってから作業を開始してください。
 ・主基板に接続されている配線のうち、メイン24Pハーネスコネクタを外しておいてください。

3. 開封作業手順 ① ~ ④

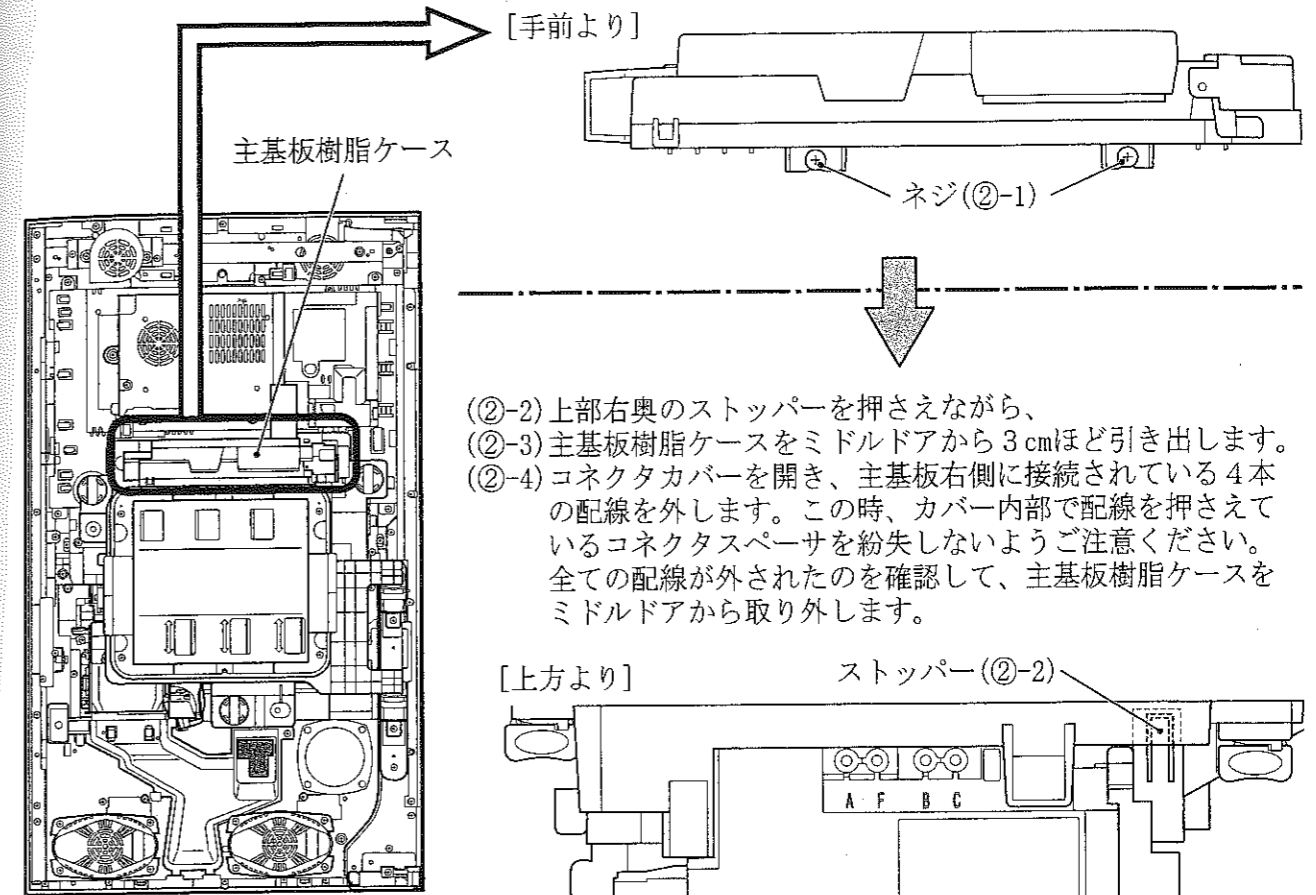
手順① 主基板樹脂ケースが本体に取り付けられた状態で、プラス (+) ドライバーを用いて封印キャップを突き破り内部のネジを外します。ケース封印 (A) および本体封印 (B) をニッパーなどを使って、

下図のように点線部から切断します。これらの作業により開封の痕跡が残ります。



手順②

(②-1) +ドライバーで主基板樹脂ケース下側奥のネジ(2ヶ所)を外します。



(②-2) 上部右奥のSTOPパーを押さえながら、
 (②-3) 主基板樹脂ケースをミドルドアから3cmほど引き出します。
 (②-4) コネクタカバーを開き、主基板右側に接続されている4本の配線を外します。この時、カバー内部で配線を押さえているコネクタスペーサを紛失しないようご注意ください。全ての配線が外されたのを確認して、主基板樹脂ケースをミドルドアから取り外します。

ドア部裏面図

手順③

手順②で取り外した主基板樹脂ケースを裏返しにします。

(③-1) 封印シールカバーを矢印の方向に引き抜きます。

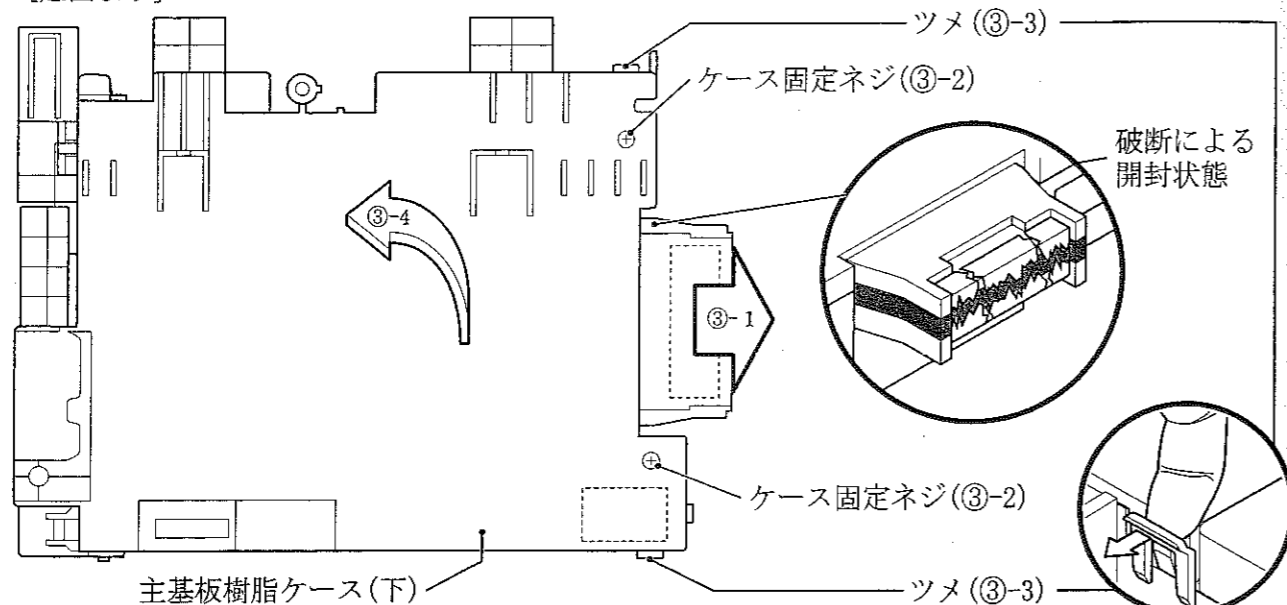
封印シールカバーを引き抜くと、下図のように封印シールが破断され、開封状態となります。
なお、封印シールカバーの引き抜きに連動して、封印シールカバー内部の部品が封印シールカバーと一緒に引き抜かれます。

(③-2) +ドライバーでケース固定ネジ(2ヶ所)を外します。

(③-3) ツメを手で広げ、

(③-4) 主基板樹脂ケース(下)を持ち上げるように開きます。

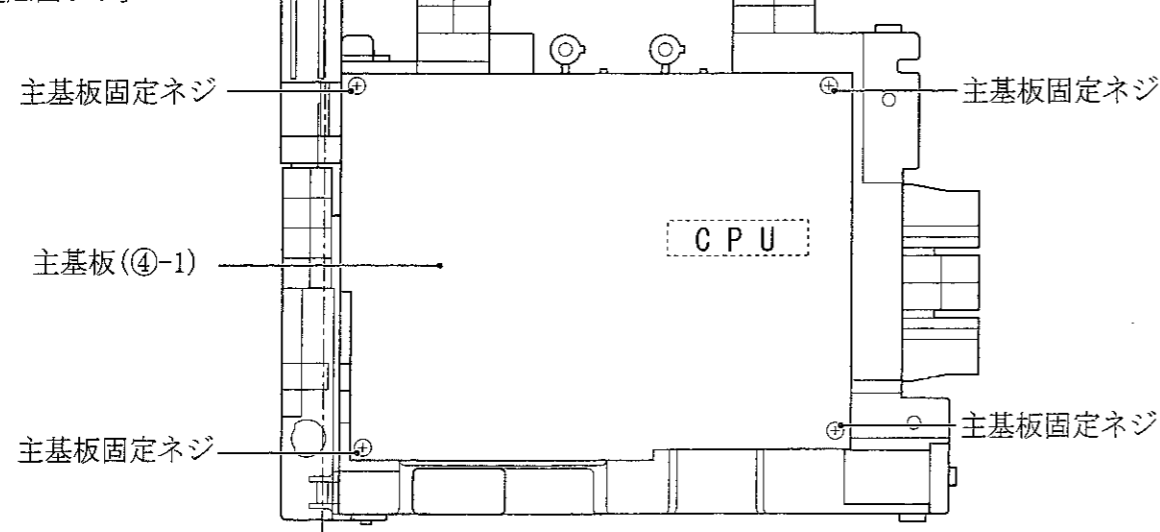
[底面より]



手順④

主基板固定ネジ(4箇所)を外してから主基板(④-1)を取り出します。

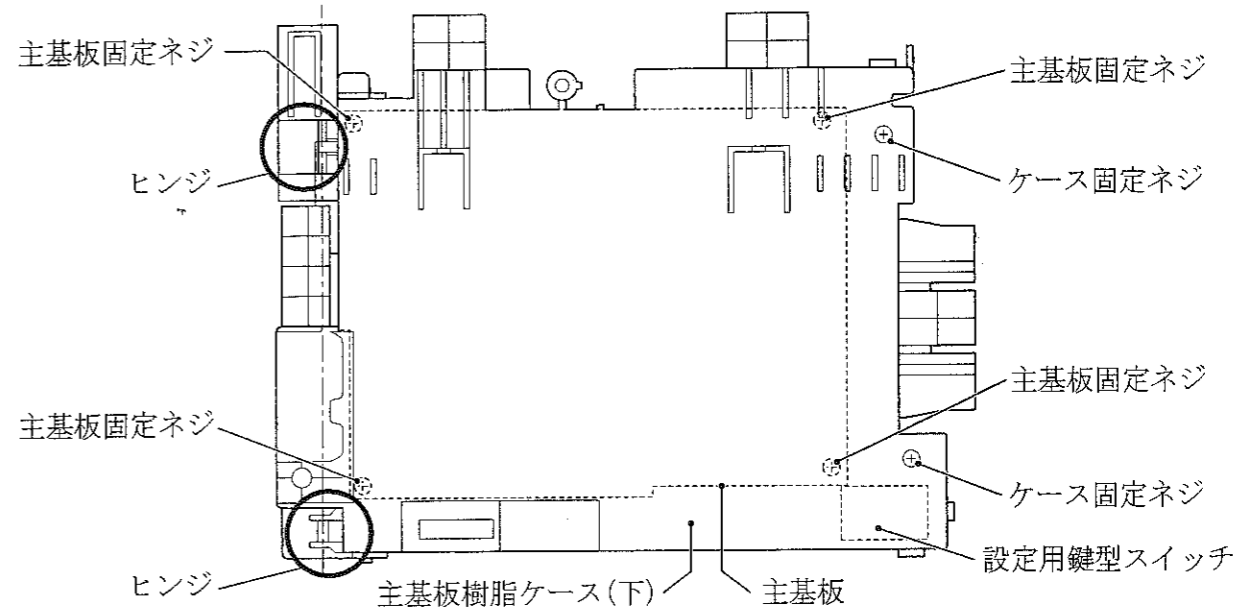
[底面より]



立入検査 (V5のチェック) 実施
基板やCPU等をチェックしてください。

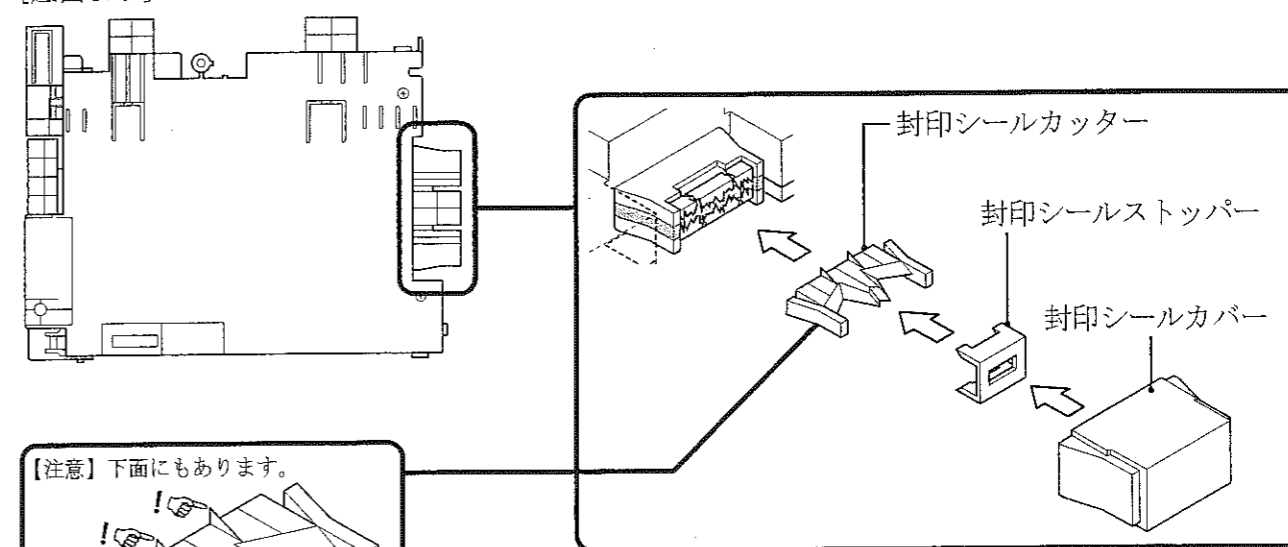
4. 封印作業手順 ⑤ ~ ⑧

手順⑤ 手順③および④の逆手順で、主基板を主基板樹脂ケースに収納し、ネジ留めをおこないます。
(主基板固定ネジで主基板を固定し、主基板樹脂ケース(下)を閉め、ケース固定ネジで固定します。)
(注意) 主基板樹脂ケース(下)のヒンジ部分のかけ違い、かけ忘れにご注意ください。
(注意) 設定用鍵型スイッチのコネクター接続忘れにご注意ください。

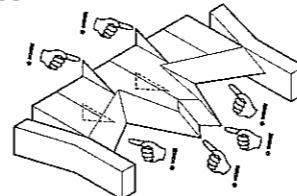


手順⑥ 手順③で引き抜いた封印シールカバーは、実際は[封印シールカバー][封印シールストッパー][封印シールカッター]の、3部品で構成されています。
これらを一旦ばらしてから、[封印シールカッター][封印シールストッパー][封印シールカバー]の順で、それぞれカチッという音がするまで確実に押し込んで組み付けます。
(注意) [封印シールカッター]の先端は非常に鋭利になっていますので取り扱いには十分ご注意ください。

[底面より]



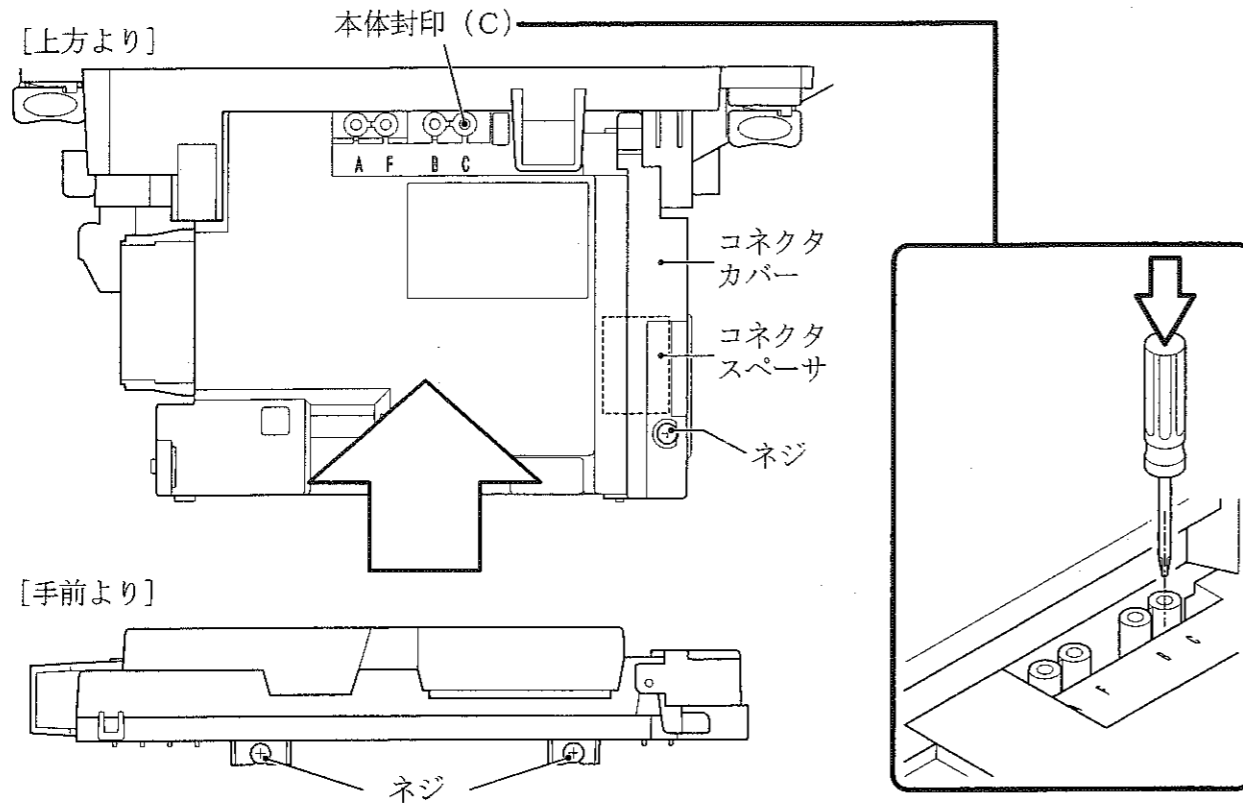
【注意】 下面にもあります。



封印シールカッター拡大図
および取り扱い注意箇所

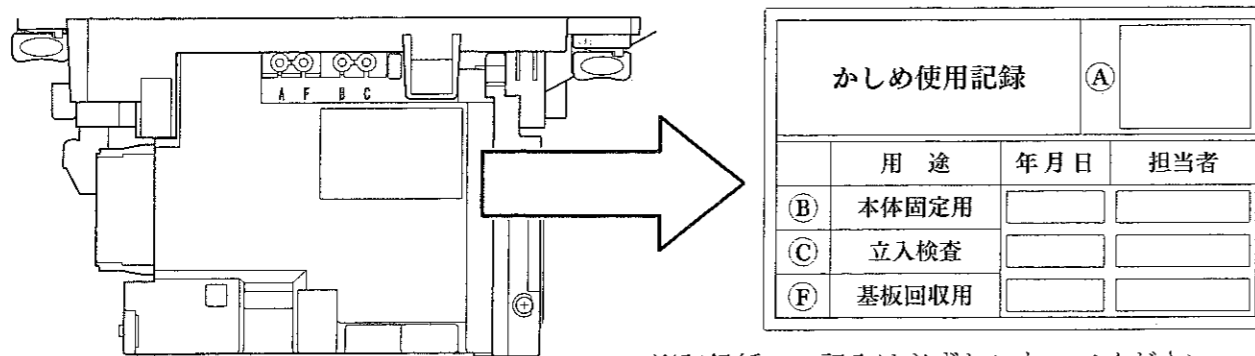
手順⑦ コネクタカバーを持ち上げて主基板樹脂ケース右側の4本の配線を接続し、コネクタスペーサを取り付けてコネクタカバーを元に戻して、主基板樹脂ケースをミドルドアに取り付けてください。
その後、メイン24Pハーネスコネクタを接続し、+ドライバーでコネクタカバーの封印キャップ内のネジ(1ヶ所)およびケース下側のネジ(2ヶ所)を固定してください。

手順⑧ 本体封印(C)を、ドライバー等を使って下方方向に押し込みます。



5. 記録作業手順 ⑨

手順⑨ 記録紙の「立入検査」の欄に年月日、担当者名を記入します。
(油性サインペン又はボールペン等を使用してください。)



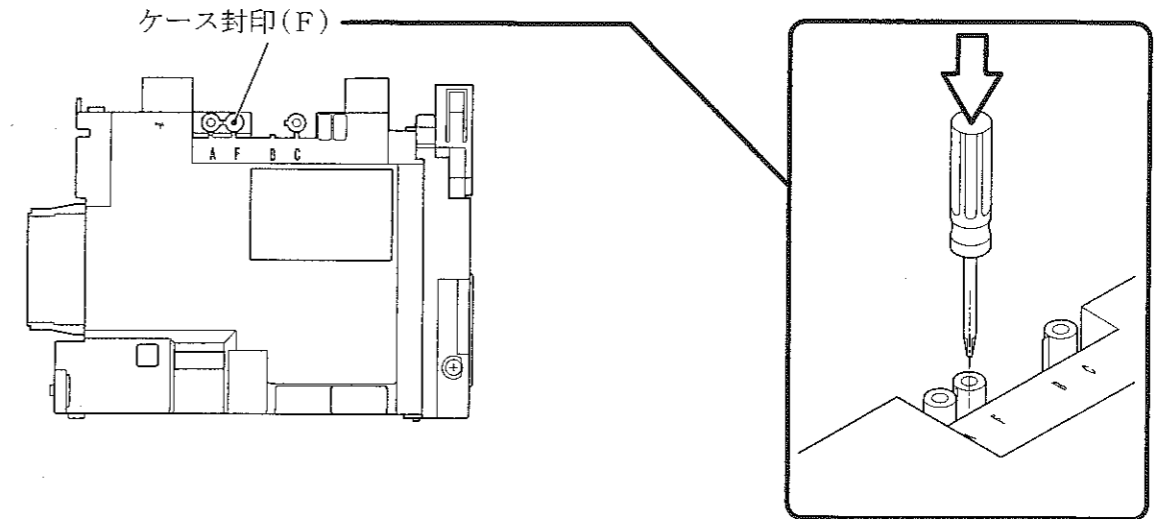
※記録紙への記入は必ずおこなってください。
記入がない場合、メーカーは保証しかねます。

(動作確認) 主基板の配線を元に戻し、機械が正常に動作することを確認してください。

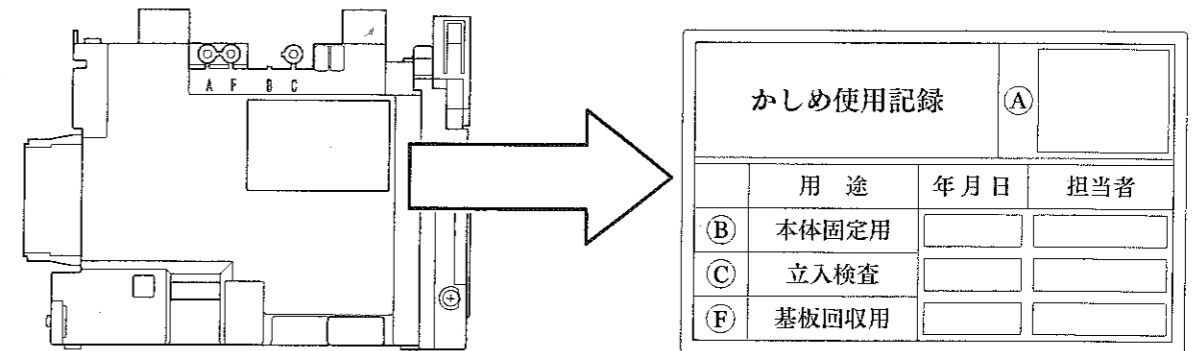
6. その他 (主基板回収時作業手順)

手順1. 「3. 開封作業手順」の手順①に従い本体封印(B)を切断し、
手順②に従い本体から主基板樹脂ケースを取り出します。

手順2. ケース封印(F)を、ドライバー等を使って矢印方向に奥までしっかりと押し込みます。



手順3. 記録紙の「基板回収用」の欄に年月日、担当者名を記入し、メーカーへ送ります。
(油性サインペン又はボールペンを使用してください。)



「ROMを搭載した周辺基板のかしめ取扱説明書」

1. 封印箇所説明図

2. HSSブリッジROM基板取り付け口の封印説明図

3. HSSブリッジROM基板取り付け口の開封説明図

1. 封印箇所説明図

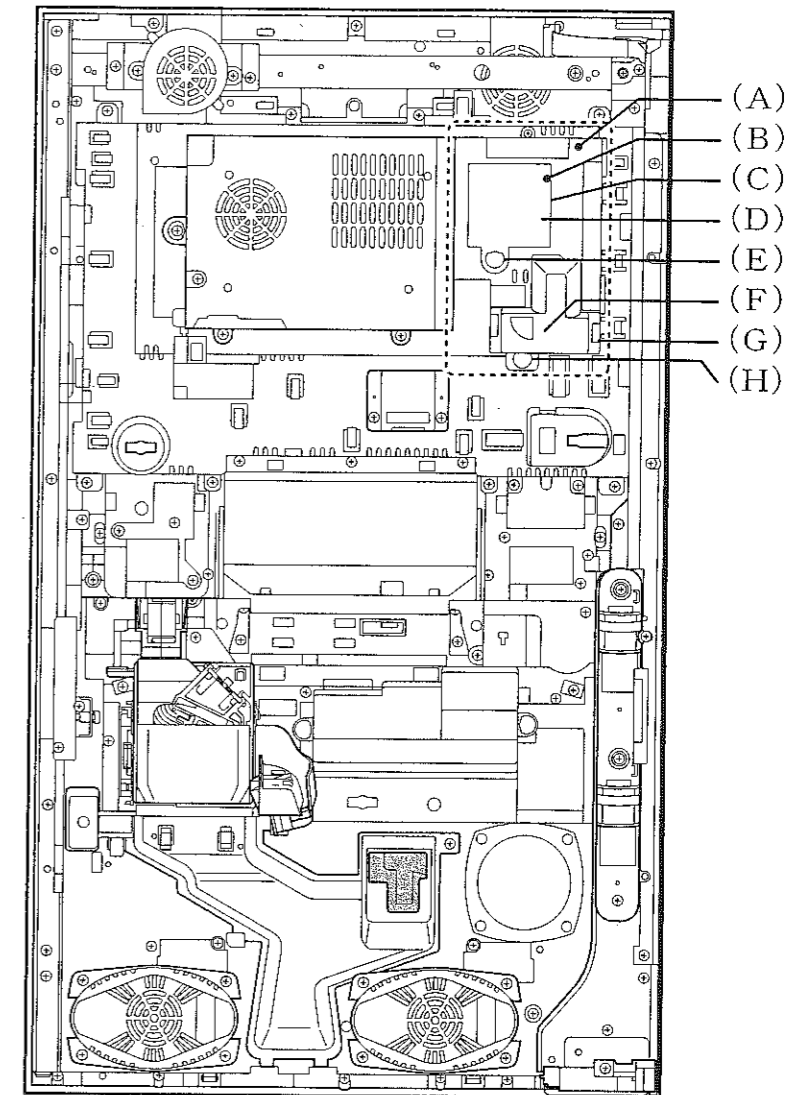
ドア部裏面に、HSSブリッジROM基板(D)を取り付けたサブ中継基板が、専用基板ケース(A)に収納された状態で取り付けられています。

サブ中継基板は、専用基板ケース(A)の内部に収納されており、ケース内にネジ留めすることで固定されています。

また、専用基板ケース(A)は、本体ドア部にネジ留めすることで固定されています。

サブ中継基板は、封印キャップ(F)及び封印キャップ(G)により専用基板ケース(A)内に封印され、そのケースは、封印キャップ(H)により封印されているため、破壊等による痕跡を残さずに開封および本体ドア部より取り外せない構造となっています。

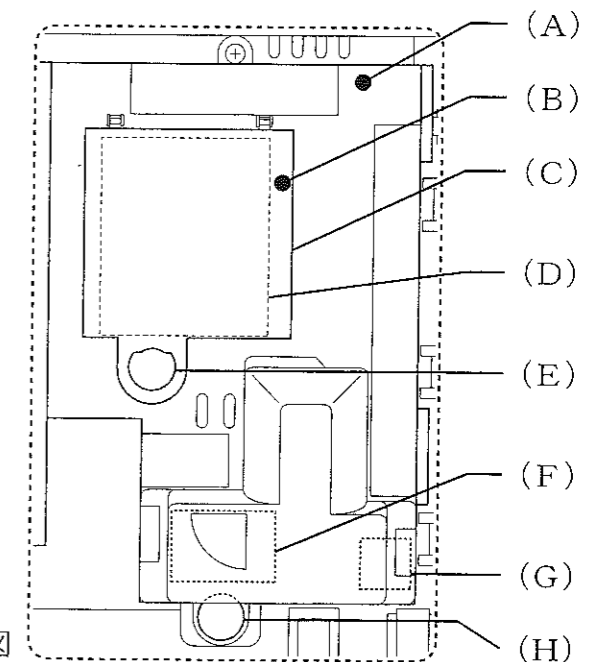
ドア部裏面図(ミドルドアは省略してあります)



2. HSSブリッジROM基板取り付け口の封印説明図

HSSブリッジROM基板の取り付け口(C)は取り付け口部ふた(B)に覆われており、そのふたは専用基板ケース(A)にネジ留めされ、封印キャップ(E)により封印されています。

封印キャップ(E)は、かしめられた状態では強く嵌合され、かつ取り外しのきっかけになりうるツメ等の部分がない構造のため、破壊を伴う方法以外での取り外しは不可能となっています。



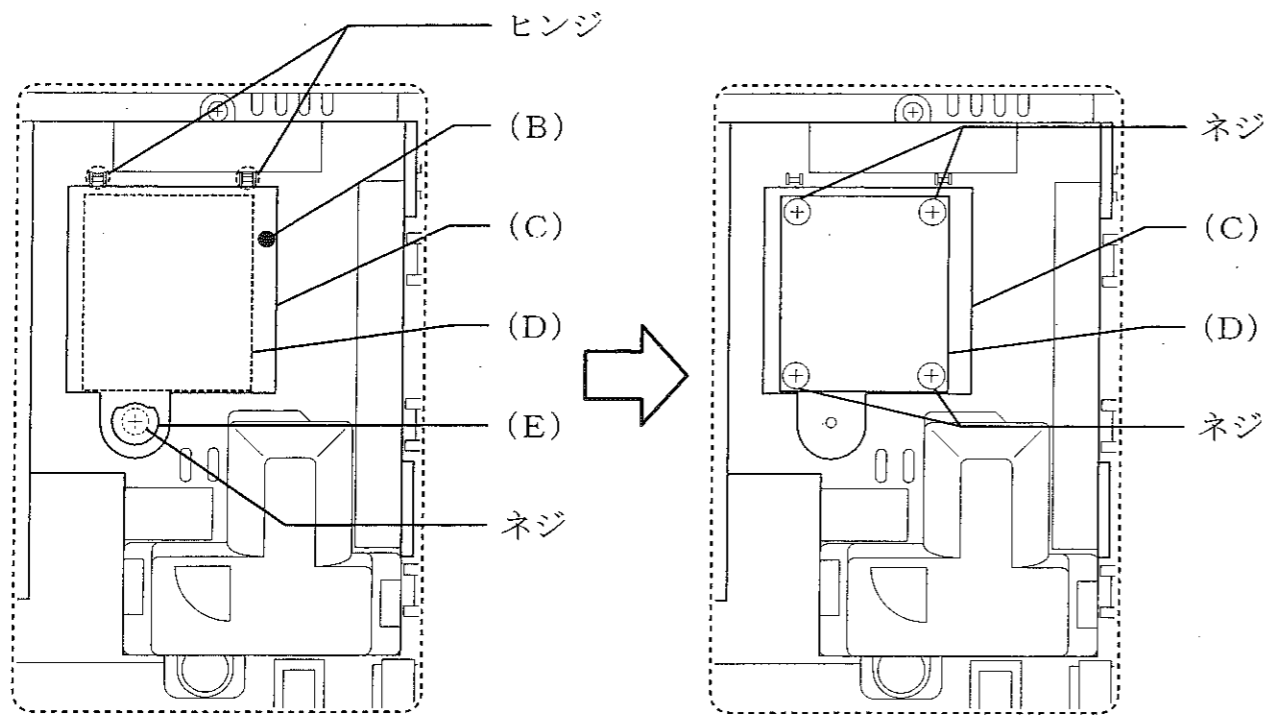
専用基板ケース(A)部拡大図

3. HSSブリッジロム基板取り付け口の開封説明図

プラス (+) ドライバーを用いて封印キャップ (E) を突き破り内部のネジを外します。
 取り付け口部ふた (B) を取り外すとネジ (4ヶ所) で固定されたHSSブリッジロム (D) 基板が現れます。

再封印は、すべて逆手順で行います。
 再封印作業の際は、取り付け口部ふた (B) 取り付け時にヒンジのかけ違い、かけ忘れにご注意ください。

専用基板ケース(A)部拡大図



取り付け口部ふた (B) 取り外し前

取り付け口部ふた (B) 取り外し後